****

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

****

*congatec unterstützt die neuen Computer-on-Modules Spezifikationen COM Express 3.0, Qseven 2.1 und SMARC 2.0 umfassend*

*Text und Foto verfügbar:* [*http://www.congatec.com/presse*](http://www.congatec.com/presse)

Pressemitteilung

**congatec stellt SMARC 2.0, Qseven 2.1 und COM Express 3.0 Roadmap vor**

**congatec unterstützt die kommenden neuen Computer-on-Modules Spezifikationen der SGET und PICMG umfassend**

**Deggendorf, 23. Februar 2016 \* \* \*** congatec, ein führender Technologie-Anbieter für Embedded Computermodule, Single Board Computer (SBCs) und Embedded Design & Manufacturing (EDM) Services, kündigt zur Embedded World die umfassende Unterstützung der kommenden neuen Computer-on-Modules Spezifikationen der SGET und PICMG zu SMARC 2.0, Qseven 2.1 und COM Express 3.0 an. Module nach diesen Standards befinden sich bereits in der Entwicklung und werden mit dem Launch der nächsten Prozessor-Generationen vorgestellt.

**Die SMARC und Qseven Roadmap**

congatec wird die SMARC 2.0 Spezifikation umfassend unterstützen. SMARC 2.0 Module wird es über die gesamte Bandbreite der relevanten Prozessortechnologien geben – vom Intel® Atom™ Prozessor bis hin zu diversen ARM Designs.

Die aktuellen Low-Power Prozessoren wird congatec auch weiterhin für Qseven 2.1 Designs unterstützen.

Der wesentliche Unterschied der beiden Standards besteht in der Anzahl der unterstützten Interfaces. Sind es bei Qseven bis zu 230 belegte Pins, kommt man bei SMARC 2.0 auf bis zu 314 Pins. SMARC zielt damit auf interfacereichere Systeme auf kleinstem Raum ab, wohingegen Qseven ideal für schlankere sowie weniger komplexe Modul- und Carrierboard-Designs ist.

congatec hat sich maßgeblich an der Entwicklung aller Standards aktiv beteiligt. Für die Qseven und SMARC Spezifikation stellt congatec sogar jeweils den Editor und ist damit ein wichtiger Technologiegeber für den Markt der besonders kompakten SFF Designs auf Basis von Computer-on-Modules, in dem sich congatec als Marktführer etabliert hat.

Christian Eder, Director Marketing von congatec, Vorstandsmitglied in der SGET und Editor der SMARC Spezifikation erklärt: “Mit dem großen Schritt von SMARC 1.1 auf 2.0 haben wir es geschafft, diesem Standard eine klare Zukunftsperspektive zu geben. Dieser enorme Fortschritt hat viele neue Interfaces gebracht und zahlreiche veraltete Features beseitigt. Obwohl Designs auf Basis von 1.1 zwar möglicherweise nicht mehr mit 2.0 kompatibel sind, werden dafür die Anwender mit zahlreichen neuen Funktionen entschädigt.“

**Die COM Express Roadmap**

Bei COM Express 3.0 wird es in erster Linie einen neuen Pinout Typ speziell für Server-on-Modules geben. Die Server orientierten Intel® Xeon® und Intel Core™ Prozessoren sowie die AMD Embedded R-Series Prozessoren sind dafür ideal. Auch ARM basierte Plattformen könnten eine Option sein.

„Alle neuen Spezifikationen bieten Entwicklern Support für neueste Interfaces und viele Verbesserungen im Detail. Neben dem vollkommen neuen SMARC 2.0 für sehr kompakte Multifunktionssysteme ist das neue COM Express Pinout für Server-on-Modules besonders innovativ. Es eröffnet uns neue Märkte im Bereich der dezentralen und echtzeitfähigen Edge-Server, die beim Mediastreaming sowie in IoT-, M2M-, Medical- und Automatisierungsapplikationen zum Einsatz kommen“, erklärt Martin Danzer, Director Product Management bei congatec.

Der persönliche Integrationsservice von congatec wird es Entwicklern zudem auch einfach machen, die neuen Revisionen in neue Systemdesigns zu integrieren. Da die meisten Funktionen zudem abwärtskompatibel sind, können in vielen Fällen bestehende Carrierboards auch mit neuen Modulen bestückt werden. Das bietet OEMs Investitionsschutz für bestehende Systemdesigns.

**Über die congatec AG**

Mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland ist die congatec AG ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren Qseven, COM Express, XTX und ETX, sowie für Single Board Computer und EDM-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec unterhält Niederlassungen in Taiwan, Japan, China, USA, Australien und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel und Intel Atom, Core und Xeon sind eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*